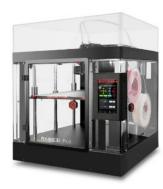


PRO3 & PRO3 Plus **HYPERSPEED**





Dernière itération des imprimantes 3D FFF de Raise3D, les Pro3 et Pro3 Plus HS (pour HYPER SPEED) bénéficient de plusieurs améliorations qui les rendent encore plus performantes et faciles à exploiter.

Bénéficiant de la technologie Hyper FFF®, les Pro3 et Pro3 Plus HS impriment entre 2,5 et 3 fois plus vite sans perte de qualité.

Très polyvalentes, les Raise3D Pro3 sont un excellent choix pour de nombreuses applications : prototypage, réalisation d'outillage, production de petites séries, formation...

Dotées de deux extrudeurs avec un système de rétraction automatique, d'un mécanisme de positionnement hyper précis, d'une reprise sur interruption, d'un plateau amovible, les Raise3D Pro3 faites sont pour une utilisation professionnelle intense.

Le plateau flexible recouvert de Buildtak permet une bonne adhésion des pièces pendant l'impression et un retrait facile une fois le travail terminé.

Le nivellement automatique multipoint garantie en permanence un réglage optimal de la hauteur des buses.



Volume maxi impression

PRO 3:300 x 300 x 300mm PRO3 Plus: 300 x 300 x 605mm



Températures maxi

Buses: 320°C Plateau: 120°C



Matériaux non propriétaires Epaisseur de couche mini : 0,05mm

Grande variété de filaments 1,75mm

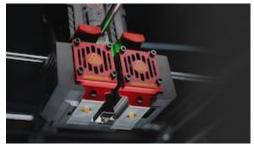
















Spécifications techniques

Modèle		PRO 3 HS	PRO 3 PLUS HS
Construction	Volume impression Max Extrusion simple	300x300x300 mm	300x300x605 mm
	Volume impression Max Extrusion double	255x300x300 mm	255x300x605 mm
	Dimension extérieure	620x626x760 mm	620x626x1105 mm
	Poids net	54 kg	64 kg
Alimentation	Entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V @3.3 A	
	Sortie	24 V DC, 600 W	
Imprimante 3D	Technologie d'impression	FFF	
	Tête d'impression	Double tête avec système de rétraction électronique	
	Diamètre filament	1.75mm	
	Pas X et Y	0.78125 micron	
	Vitesse d'impression standard	300 mm/s	
	Plateau	Plateau d'acier flexible / adhésion sur Buildtak	
	Température max du plateau	120°C	
	Matériau du lit chauffant	Silicone	
	Mise à niveau du plateau	Calibration automatique (multi-points)	
	Détecteur de fin de filaments	Oui	
	Matériaux	PLA, ABS, HIPS, TPU, TPE, NYLON, PETG, ASA, PP, PVA	
	Hauteur de couches minimum	0,05 mm	
	Diamètres de buses	0.4 mm (standard), Autres 0.2 / 0.6 / 0.8 / 1.mm	
	Température maxi des buses	320°C	
	Connectivité	Wi-Fi, LAN (RJ45), Port USB, Caméra en direct	
	Niveau sonore	<55dB(A) lors de la modélisation	
	Température ambiante de fonctionnement	15 - 30°C, 10-90% % HR sans condensation	
	Filtre	Filtre HEPA avec charbon actif	
	Smart assistant	EVE	
Logiciel	Logiciel de tranchage (slicer)	IdeaMaker	
	Types de fichiers pris en charge	STL / OBJ/ 3MF/ OLTP / STEP / STP / IGES / IGS	
	Support OS	Windows/ macOS/ Linux	
	Type de code machine	GCODE	
Contrôleur d'impression	Interface utilisateur	Écran tactile de 7 pouces	
	Réseau	Wi-Fi, Ethernet	
	Reprise de l'impression après interruption	Oui	
	Résolution écran	1024x600	
	Contrôleur de mouvement	ARM Cortex M4 120 MHZ FPU	
	Contrôleur logique	NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 Ghz	
	Mémoire interne	1 GB	
	Mémoire Flash embarqué	16 GB	
	OS	Linux embarqué	
	Ports	2 x USB 2.0, 1 x Ethernet	





